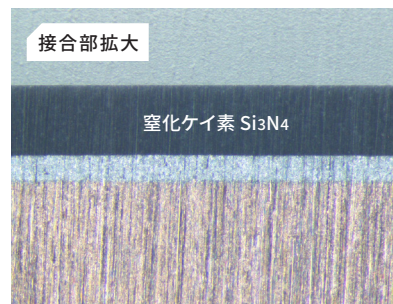
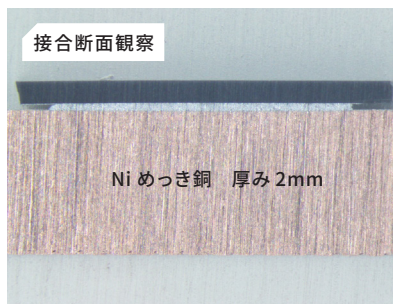
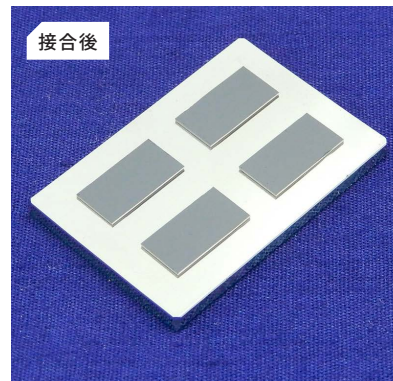
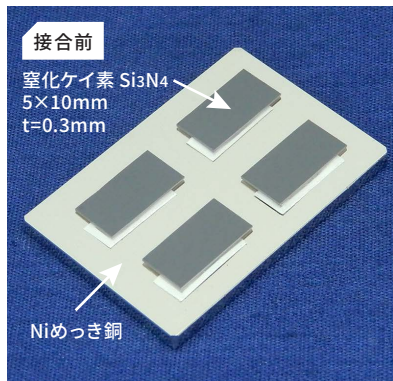




Bonding ボンディング

セラミックス基板とヒートシンクのダメージのない
異材料間一括接合



Point ここがポイント

- ✔ 窒化ケイ素基板とNiめっき銅製ヒートシンクの異材料間接合
- ✔ 4個のセラミックス基板を一括同時接合
- ✔ ヒートショックテストクリア (-50~600°C)
- ✔ 音エネルギーのみで接合
- ✔ 大気中常温接合
- ✔ 接合のエネルギー源は電気とエア
- ✔ デスクトップ接合

Product used 使用する装置

- ✔ 15MZs



AP-J-0096A4-2025041001